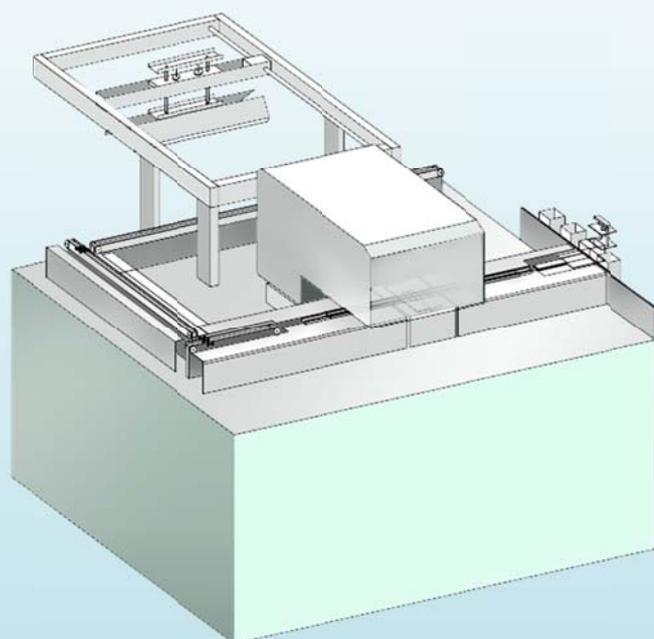


コンパクト/高速/高精細/印刷システム

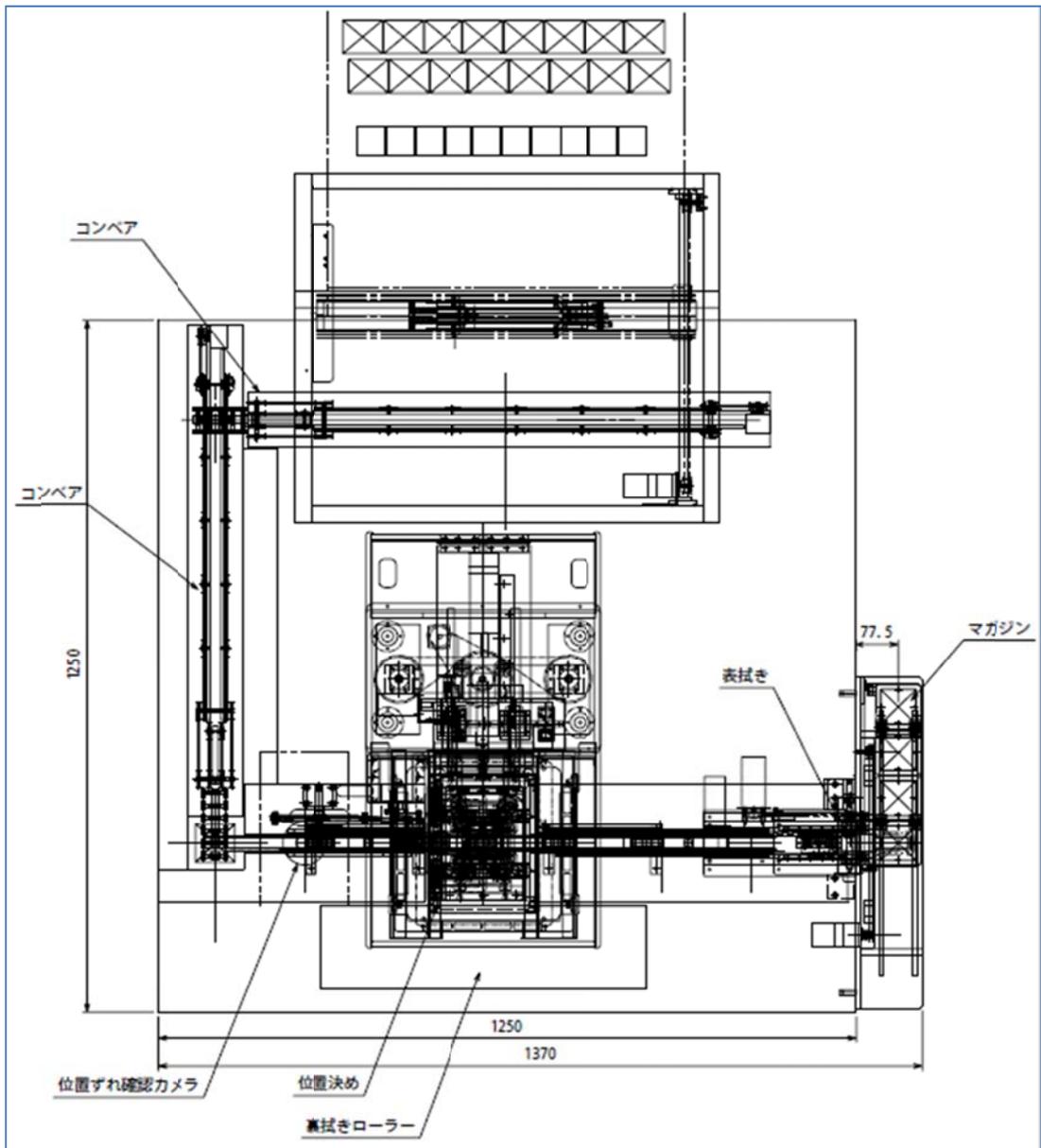


従来比半分のフットプリントで倍の高速も可能

- ・吸着ウォーキングによる高速、で各種品種に瞬時に
対応します。
- ・サーボセンタリング方式による、基板にやさしく
高精度、高速位置決め
- ・印刷後の画像検査ステージを装備します。
- ・印刷機は低フリクション印圧機構により高追従性、
高精細、高速印刷を可能とします。
- ・スクリーン毎に記憶されたサーボ XYθ 位置合わせ
機構は少量多品種でも短時間で位置合わせ可能で
す。
- ・コンベア排出機構により、基板サイズとピッチ、枚
数に変更可能で、炉の能力を最大限利用し生産性
を高めます。
- ・乾燥炉の炉長の短縮化を狙い、ホットプレス式
コンベア炉で実証予定です。

次世代チップ抵抗印刷システム FL300 シリーズ

対象ワーク	MIN50×60～MAX60×70 縦印刷(標準)、縦横搬送(OP)
位置決め方式	サーボセンタリング方式 スクリーン XYθサーボ駆動
能力	最速タクト 3.5 秒/枚(標準)2.5 秒/枚(OP)、繰返し精度±10ミクロン以下
マガジン 表拭き	供給 2 本(標準)、4 本(OP)、H=200mm 表拭き無(標準)、有り(OP)
外形寸法	W1270×D1300(コロケータ含まず)×H1700
質量	500kg
印刷後画像検査ステージ	無(標準)、ステージあり(OP)、システム有り(OP)
排出	最大炉幅 600mm、整列枚数は基板によりピッチ枚数を可変(収納機改)



イメージ図(従来品 vs 新型)

